

故障解析を通じて、 ものづくりを支援します

チームの概要

故障解析のコア技術である「X線を用いた非破壊検査」ならびに、「固体表面の元素分析」を中心取り組んでいます。

1) X線による非破壊検査

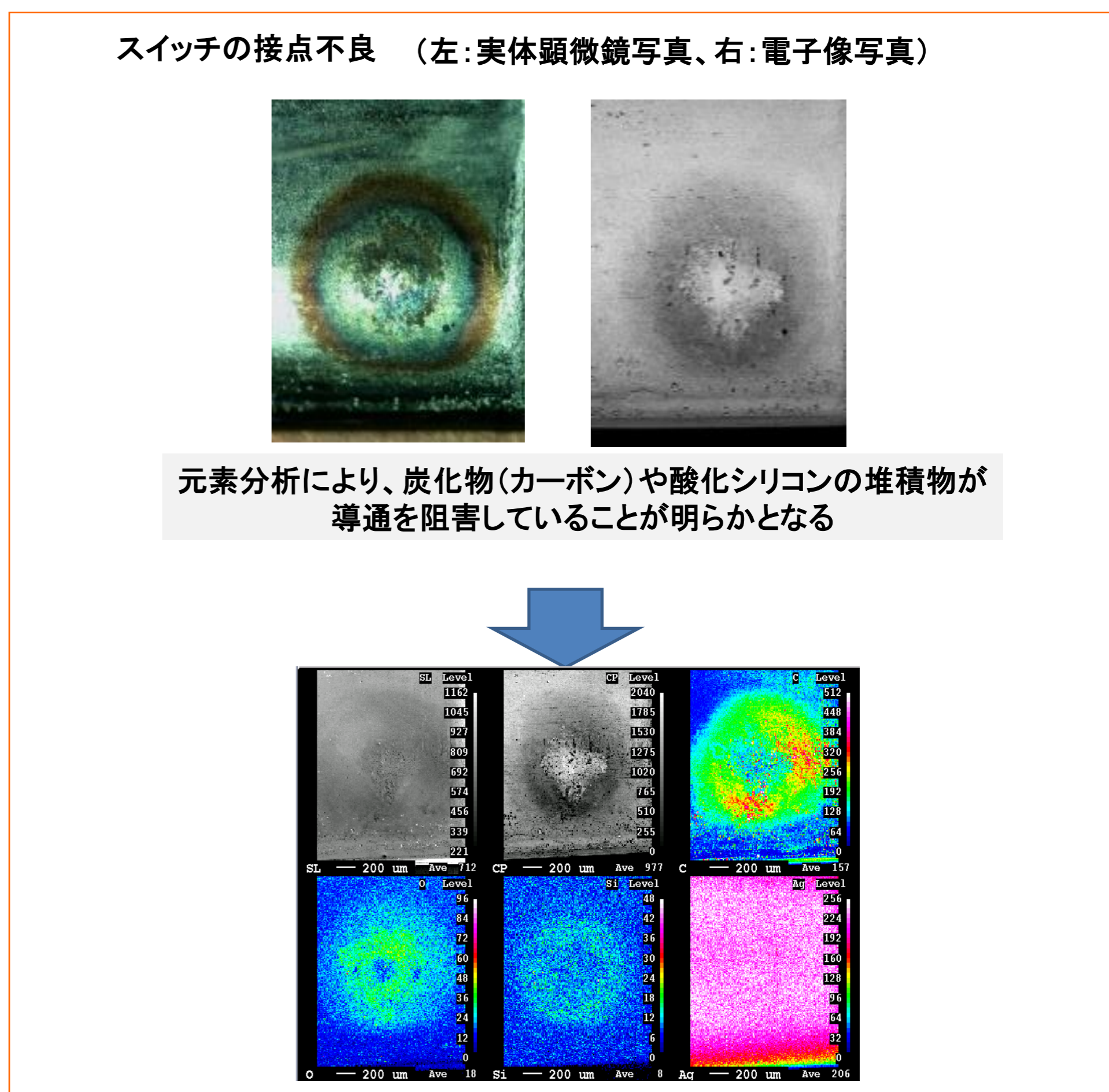
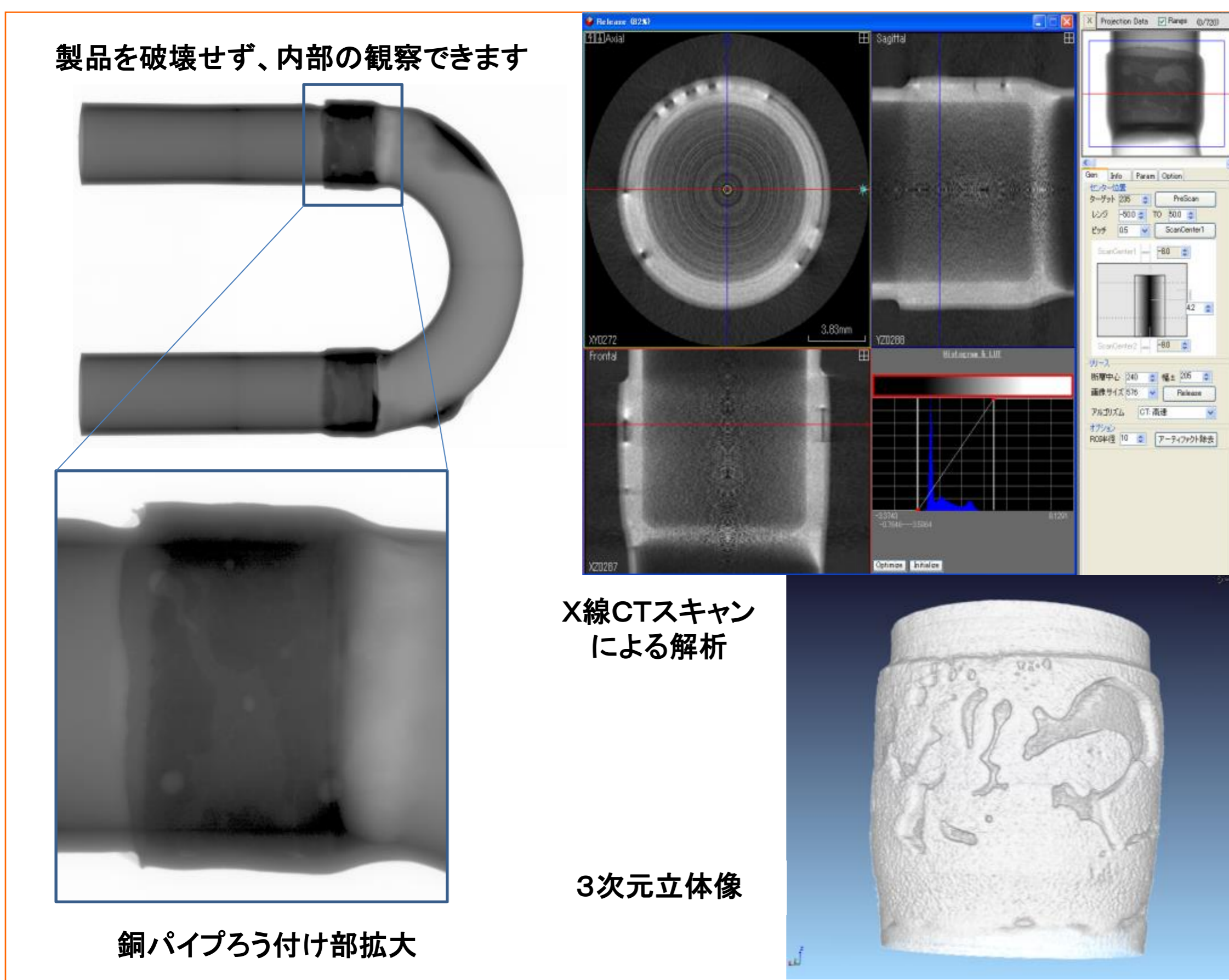
マイクロフォーカスX線テレビ装置
X線CTスキャン装置

サンプル内部の構造や欠陥を調べます。
対象は金属・プラスチック・複合部品、電子基板・実装関係の電子部品などになります。

2) 固体表面の元素分析

電子線マイクロアナライザ(EPMA)
X線光電子分光分析装置(XPS)

接点不良や変色、摺動、腐食、異物等の原因を追究します。



接点不良解析事例

受託研究・依頼試験事例

- 電子回路基板やろう付部などX線透過検査
- 新素材・電子回路基板・電子部品・ろう付部などについてのX線による断層撮影
- EPMA、XPSを使った固体表面の元素分析